

## 大连百傲化学股份有限公司

# 关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订《半导体设备业务合作协议》的补充暨进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、本次交易情况概述

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟签署半导体设备业务合作协议的议案》，公司拟委托苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）以自有资金购买半导体设备，合同价款合计不超过人民币14,000.00万元，由芯慧联负责对其进行再制造、升级改造和技术服务及对外销售，本次合作产生的利润按协议约定的方式进行分成。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订〈半导体设备业务合作协议〉的公告》（公告编号：2024-006）。为使投资者进一步了解相关情况，现就上述事项进行补充并说明进展情况，内容如下：

### 二、交易对方基本情况

名称：苏州芯慧联半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1XQTA97M

法定代表人：刘红军

住所：常熟高新技术产业开发区金门路2号2幢

成立日期：2019-01-08

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：半导体、平板显示科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；半导体静电卡盘生产，静电卡盘整机设备及零配件组装；设备安装、维修、维护、清洗、翻新；金属材料、通讯器材、仪器仪表、机械设备、五金交电、电子产品、电子元器件、化工产品（不含危险化学品）销售；压力管道工程、机电安装工程的设计、施工；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

芯慧联最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币/元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 31 日
资产总额	480,513,192.75	513,900,033.67
负债总额	311,027,239.34	349,999,894.90
净资产	169,485,953.41	163,900,138.77
项目	2023 年度	2024 年 1 月
营业收入	182,811,765.64	14,255,502.17
净利润	-47,502,622.01	-9,214,018.42

注：上述财务数据未经审计。

经查询，芯慧联不属于失信被执行人，具有良好的资信和履约能力。

公司与芯慧联及其股东不存在关联关系。

### 三、本次交易进展

上述《半导体设备业务合作协议》已于 2024 年 2 月 7 日完成签署，协议的内容与《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司拟签订〈半导体设备业务合作协议〉的公告》（公告编号：2024-006）之“三、拟签订协议的主要内容”一致。

### 四、风险提示

由于本次委托芯慧联购买的半导体设备为海外进口设备，交易期限较长，可

能会因为国家的政策、市场、金融环境等不确定因素的变化以及卖方交货时间、再制造、升级改造和修理、维护进度等因素影响本协议的履行程度及项目进度，公司将严格按照相关法律法规的要求，对本次交易的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024年2月8日